

证券代码：301369

证券简称：联动科技

## 佛山市联动科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：投 2023-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	1、易方达基金 祁禾、何崇恺、欧阳良琦。
时间	2023 年 1 月 12 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书邱少媚女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、 公司基本情况介绍</b></p> <p>公司成立于 1998 年，于 2001 年推出应用于后道封测环节的激光打标设备，鉴于公司在激光打标设备领域积累了丰富的下游客户资源、封测产线应用经验以及自动化控制技术，经过大量的研发投入、实验验证和应用积累，公司于 2003 年起逐步切入半导体分立器件测试领域，于 2009 年推出了小信号分立器件高速测试系统，持续对产品进行技术迭代、拓宽产品应用范围，产品可满足高功率、高速率、高精度及第三代半导体等功率半导体的测试需求，发展成为半导体分立器件测试系统的龙头企业，2021 年市场占有率接近 30%。公司在分立器件测试系统的基础上，研发出了 QT-8000 系列模拟及数模混合集成电路测试系统产品，自 2018 年大力推广以来，随着市场开拓和客户认证的不断推进，实现了该类产品收入规模的较快增长，未来市场空间广阔。</p> <p>公司客户覆盖面较广，包括长电科技、通富微电、华天科技、扬杰科技、捷捷微电、三安光电、成都先进、安森美集团、安靠集团、力特半导体、威世集团等国内外知名半导体厂商。</p> <p><b>二、 问答环节</b></p> <p><b>1、请介绍公司新产品研发及市场拓展情况？</b></p> <p>回复：分立器件测试系统方面，功率半导体分立器件测试系统是公司的重点布局方向，公司最新推出 QT-8400 系列测试系统，主要面向高功率、高速率、高精度及第三代半导体晶圆和模块的测试需求，目前正在大力推广中，备受客户关注，是公司未</p>

来主要业务增长点之一。

集成电路测试系统方面，公司模拟及数模混合集成电路测试系统的技术性能和产线应用已成功得到了华天科技、通富微电、利扬芯片、安森美集团等知名客户的有效验证并实现批量供货；公司在研的大规模混合信号测试系统，通过对现有 QT-8000 系列模拟及数模混合集成电路测试系统的功能模块完善和技术指标升级，从而满足模拟及数模混合集成电路芯片不断提高的测试要求；公司的 QT-9000 大规模数字集成电路测试系统面向数字及部分 SoC 类芯片的测试需求，正处于研发验证阶段。数字及 SoC 类集成电路测试领域市场空间巨大，该产品的研发将有助于公司进一步提升数字通道的性能水平及同步精度，拓展数字及 SoC 类集成电路的测试能力，加快公司在数字及 SoC 类集成电路测试领域的布局，获取更为广阔的市场空间。

## **2、公司在功率半导体分立器件测试领域的技术优势及未来布局？**

回复：半导体自动化测试系统的技术关键点是通过持续研发创新、优化电路设计和迭代软件算法，使测试系统覆盖更多的功能模块，测试资源更多，测试范围更广，测试功率密度更大，测试精度更高，并行测试能力更强，设备性能具有更高的一致性、稳定性和可靠性。公司的 QT-4000 系列功率器件综合测试平台，能满足 300A/6KV 高压源、超大电流源等级的功率器件测试要求，测试功能涵盖直流及交流测试并能够进行多工位测试的数据合并，以及第三代半导体新材料 GaN 动态导通电阻（DRDSON）的测试，能够满足目前主流的功率半导体芯片和第三代半导体新材料测试要求，是目前国内功率器件测试能力和功能模块覆盖面最广的供应商之一。

目前公司半导体分立器件测试系统已大量应用于大功率器件和第三代半导体器件的测试，代表客户包括安森美集团、安靠集团、力特半导体、通富微电、扬杰科技、斯达半导体、三安光电等。未来，公司将根据半导体下游应用的新技术、新工艺和新材料的发展情况，依托现有的技术储备，持续加大对半导体功率分立器件的研发投入，不断提升大功率器件和第三代半导体参数的测试能力，以及晶圆级多工位的测试能力，把握新能源、电动汽车、高铁等大功率应用领域的发展机遇，逐步实现大功率器件如 IGBT 及功率模块测试的进口替代。

## **3、请介绍公司的激光打标设备及未来布局？**

回复：半导体激光打标设备主要是通过利用不同的激光技术，实现各类半导体元器件的精密激光打标，打标内容包括公司名称、产品型号等。公司的激光打标设备主要应用于半导体后道封测环节，包括全自动激光打标设备和非全自动激光打标设备。

目前公司的激光打标设备主要为应用于半导体后道封测环节的非全自动激光打标机，市场规模相对较小。全自动激光打标

	<p>设备的市场空间较大，通常以封测产线系统配套商整体供应为主，且系统配套商以境外公司为主，国外公司有较强的先发优势，目前该领域还是以德国 ROFIN、韩国 EO 等进口设备为主。</p> <p>未来公司将进一步加大大全自动激光打标设备的市场推广力度，通过深度参与到客户的产线自动化设计中，逐渐实现批量供货以及在客户的原有封测项目的改造中，凭借相当的技术能力和服务优势，替代国外产品，随着市场推广成效逐渐显现，有望给公司业务增长带来更多的空间。</p> <p><b>4、请问公司技术研发人员的人才储备情况？</b></p> <p>回复：公司重视对研发人员的选拔、培养、任用，形成了一支结构稳定、权限明确、配置合理的研发团队。公司采用内部培养和外部招聘相结合的方式进行研发人才储备，公司研发人员为掌握各类技术、材料、工艺、设备、微系统集成等多领域知识的专业人员，在资深技术人员的“传、帮、带”下，逐步积累测试设备的知识储备和从业经验，成长为具备丰富经验的高端人才。公司也建立了规范的培训体系和招聘机制，建设了成熟、高效的梯队人员储备体制，保证及时有适格的员工弥补人员变动而导致的职位空缺，不影响公司的研发工作。</p> <p><b>5、请谈谈公司对行业景气度的看法？</b></p> <p>回复：公司所在的半导体行业后道封装测试领域专用设备行业位于半导体产业的上游。半导体产业处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础，与宏观经济形势密切相关，具有周期性特征。2022 年，国内持续受到疫情影响，宏观经济增速放缓，传统消费电子需求低迷，行业景气度有所回落。2023 年，随着新冠疫情管控措施优化及疫情缓解，经济复苏，消费电子需求有望逐步回升。</p> <p>公司对行业的中长期发展保持看好。一方面，近年来国家陆续出台一系列鼓励政策，推动下游客户所在的半导体封测和功率半导体领域的发展，尤其是 IGBT、第三代半导体、先进封装等重点领域，得到国家政策的高度重视和大力支持，促进了公司下游客户对于半导体封装测试需求的稳定性和持续性。另一方面，受益于国内新能源行业以及汽车电动化和智能化的强劲需求，国内功率半导体市场规模发展迅速，成为全球最大的功率半导体消费国，具有广阔的国产替代空间。功率半导体市场的稳定增长与国产替代进程的加速将会持续带动下游客户对封测项目的产能投资，将为公司功率半导体测试系统的业务拓展带来新的发展机遇和市场空间。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 1 月 13 日